

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：981)

須予披露交易

根據商業條款協議及購買單作出購買

本公司公布：

- (1) 本公司已根據商業條款協議於二零一九年二月至二零二零年一月的12個月期間就機器及設備向應用材料發出一系列購買單。

由於根據上市規則第14章有關應用材料購買單的最高相關百分比率為5%以上但低於25%，應用材料購買單構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的公告規定。

- (2) 本公司已於二零一九年二月至二零二零年一月的12個月期間就機器及設備向阿斯麥發出一系列購買單。

由於根據上市規則第14章有關阿斯麥購買單的最高相關百分比率為5%以上但低於25%，阿斯麥購買單構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的公告規定。

緒言

本公司已訂立以下協議：

- (1) 就本公司購買將用於生產晶圓的應用材料產品與應用材料訂立商業條款協議；
及
- (2) 就本公司購買將用於生產晶圓的阿斯麥產品的阿斯麥購買單。

商業條款協議提供購買應用材料產品的框架。根據商業條款協議作出的購買乃通過本公司發出購買單(連同所需應用材料產品的列表)，方可生效。

阿斯麥批量採購協議為載入阿斯麥購買單的條款及條件的參考。

(1) 商業條款協議及應用材料購買單

商業條款協議

日期及訂約方

日期：二零零一年四月十六日並於二零一九年四月三十日修訂

訂約方：

- (1) 本公司
- (2) 應用材料

董事確認，經作出所有合理查詢後所深知、所悉及所信，應用材料及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

協議年期

本協議的有效期直至二零二二年四月三十日止。

商業條款協議的主要條款

付款

應用材料產品及其他設備的定價於每次根據商業條款協議發出購買單時另行釐定。

每項應用材料產品的付款條款為：

- (a) 美元淨發票價值的百分之九十(90%)(且不得以應用材料接納的不可撤銷信用證扣減或抵銷)於提交付運文件時即期應付；及
- (b) 美元淨發票價值的百分之十(10%)(且不得以應用材料接納的不可撤銷信用證扣減或抵銷)於以下日期到期應付(以較早者為準)：
 - (1) 最終技術簽核；及
 - (2) 付運日期起九十(90)天。

其他設備的付款條款為美元淨發票價值的100%(且不得以應用材料接納的不可撤銷信用證扣減或抵銷)於發票日期起足30天到期應付。

付運

根據商業條款協議作出購買的付運條款應為按照國際貿易術語解釋通則2000年版FCA(貨交承運人)承包商的處所或指定付運點。每項應用材料產品的所有權及遺失風險應於應用材料於FCA地點完成交付責任時轉移至本公司。

其他條款

本公司可於任何時間於確認交付獲授權代表簽署的通知書予應用材料後，在支付基於根據協議給予預先通知款額計算的取消費後，取銷根據協議發出仍未作出交付的任何購買單。

應用材料購買單

應用材料購買單乃於二零一九年二月至二零二零年一月之間就應用材料向本公司供應用於生產晶圓的機器而作出。

根據應用材料購買單購買的應用材料產品定價乃按公平基準釐定。應用材料購買單的總代價為620,346,872美元。

(2) 阿斯麥批量採購協議及阿斯麥購買單

批量採購協議

日期及訂約方

日期：二零一八年一月一日

訂約方：

- (1) 本公司
- (2) 阿斯麥

董事確認，經作出所有合理查後所深知、所悉及所信，阿斯麥及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

協議年期

本協議的有效期直至二零二零年十二月三十一日止。

批量採購協議的主要條款

付款

阿斯麥產品及其他設備的定價於每次根據批量採購協議發出購買單時另行釐定。

每項阿斯麥產品的付款條款為：

- (1) 於發出相關購買單後約百分之三十(30%)的首期付款；及
- (2) 餘下款額將於交付相關阿斯麥產品時支付。

付運

根據阿斯麥購買單作出的購買的付運條款應為FCA (貨交承運人) 承包商的處所或指定目的地交貨(DAP)。

購買單

阿斯麥購買單乃於二零一九年二月至二零二零年一月之間就阿斯麥向本公司供應用於生產晶圓的機器而作出。

根據阿斯麥購買單購買的阿斯麥產品定價乃按公平基準釐定。阿斯麥購買單的總代價為538,997,169美元。

有關訂約方的資料

本公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，本公司也是中國內地技術最全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業。本公司提供0.35微米到14納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。本公司的總部位於上海，擁有全球化的製造和服務基地。在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠，以及一座控股的300mm先進製程晶圓合資廠(在建中)；在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm先進製程晶圓廠；在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠；在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠。本公司還在美國、歐洲、日本和台灣地區設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。

應用材料為材料工程解決方案的領先公司，為製造半導體芯片提供設備、服務及軟件。

阿斯麥為半導體業的全球領先供應商之一。阿斯麥向全球芯片製造商提供硬件、軟件及服務。

訂立商業條款協議的理由及裨益

本公司為中國最先進及最大的集成電路製造商。為應對客戶的需要，本公司繼續擴大其產能、把握市場商機及增長。

商業條款協議、批量採購協議、應用材料購買單及阿斯麥購買單乃於本公司正常業務過程中就購置用於生產晶圓(為本公司主要業務)的相關機器作出。

董事認為，商業條款協議、批量採購協議、應用材料購買單及阿斯麥購買單各自的條款公平合理，符合本公司及其股東整體的利益。

上市規則的涵義

應用材料購買單為根據商業條款協議於12個月期間作出的一系列應用材料產品購買，而根據上市規則第14.22及14.23條，將合併計算及視作有關購買的單一交易。

由於有關應用材料購買單的最高相關百分比率為5%以上但低於25%，應用材料購買單構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的公告規定。

阿斯麥購買單為於12個月期間作出的一系列阿斯麥產品購買，而根據上市規則第14.22及14.23條，將合併計算及視作有關購買的單一交易。

由於有關阿斯麥購買單的最高相關百分比率為5%以上但低於25%，阿斯麥購買單構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「應用材料產品」	指	由加工及度量衡工具組成的資本設備及其他非系統訂單；
「應用材料購買單」	指	於二零一九年二月至二零二零年一月根據商業條款協議就應用材料產品發出的購買單；
「應用材料」	指	應用材料有限公司；
「阿斯麥」	指	阿斯麥香港有限公司；
「阿斯麥產品」	指	由掃描器組成的資本設備；
「阿斯麥購買單」	指	於二零一九年二月至二零二零年一月根據批量採購協議就阿斯麥產品發出的購買單；
「董事會」	指	董事會；
「商業條款協議」	指	本公司與應用材料訂立日期為二零零一年四月十六日並於二零一九年四月三十日修訂的商業條款協議；
「本公司」	指	Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯國際集成電路製造有限公司*)；
「董事」	指	本公司董事；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣)；

「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；
「美國」	指 美利堅合眾國；
「美元」	指 美元，美國的法定貨幣；
「批量採購協議」	指 本公司與阿斯麥訂立日期為二零一八年一月一日的批量採購協議；及
「%」	指 百分比。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
 執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書
高永崗

中國上海
 二零二零年一月二十四日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (董事長)
 趙海軍 (聯合首席執行官)
 梁孟松 (聯合首席執行官)
 高永崗 (首席財務官兼聯席公司秘書)

非執行董事

陳山枝
 周杰
 任凱
 路軍
 童國華

獨立非執行董事

William Tudor Brown
 叢京生
 劉遵義
 范仁達
 楊光磊

* 僅供識別